

苏州锆威特半导体股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资 结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州锆威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“功率半导体研发工程中心升级项目”新增位于张家港市杨舍镇新泾东路 616 号的租赁厂房作为实施地点，实施方式由购置办公楼调整为购置办公楼及租赁厂房，同时调整该募投项目的内部投资结构。

● 本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。

● 本次事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锆威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资

金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际经营情况与发展规划，提升募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的开发进度，2026年3月6日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的议案》，本次调整涉及新增“功率半导体研发工程中心升级项目”实施地点，并调整实施方式由购置办公楼调整为购置办公楼及租赁厂房，同时调整该募投项目的内部投资结构。“功率半导体研发工程中心升级项目”总募集资金投资金额不变。该事项尚需提交公司股东会审议。募集资金投资项目基本情况及本次调整前后募集资金投资项目情况如下：

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	75,213.16
募集资金净额	66,479.89
募集资金到账时间	2023年8月14日
涉及变更投向的总金额	0
涉及变更投向的总金额占比	0%
改变募集资金用途类型	<input type="checkbox"/> 改变募集资金投向 <input type="checkbox"/> 改变募集资金金额 <input type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式 <input type="checkbox"/> 实施新项目 <input type="checkbox"/> 永久补充流动资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2023年首次公开发行股份	功率半导体研发中心升级项目	苏州锴威特半导体股份有限公司	杨舍镇沙洲湖科创园B2幢	16,807.16	16,807.16	3,497.81	3,497.81	是	2023年首次公开发行股份	功率半导体研发中心升级项目	苏州锴威特半导体股份有限公司	杨舍镇沙洲湖科创园B2幢、杨舍镇新泾东路616号	16,807.16	16,807.16	否

注：已投入金额为截至2025年12月31日累计投入募集资金金额，以上数据未经审计。

二、本次部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的具体原因

公司首次公开发行股票募投项目“功率半导体研发工程中心升级项目”原计划通过购置位于杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢办公楼实施，该地点为办公室、实验室一体的办公楼。

结合公司业务发展实际及项目推进需求，本次拟新增实施地点、调整实施方式，并优化内部投资结构，原因主要系随着公司业务在高可靠领域、工业控制领域的持续拓展，原有实施场所发展空间受限，已无法满足项目推进的核心需求：一方面导致可靠性考核实验能力不足，难以支撑现有及未来增长的市场需求；另一方面，结合公司申请CNAS实验室的战略规划，原有区域面积及场地条件已无法满足CNAS实验室建设及运营的相关要求。

因此，公司拟在原有实施地点基础上，新增租赁位于杨舍镇新泾东路616号的厂房作为项目实施场所，同步调整实施方式、优化内部投资结构，保障项目顺利推进、实现预期建设目标。

三、本次部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的具体内容及必要性

（一）本次部分募投项目调整的具体情况

公司经审慎研究，根据募投项目的实际实施情况，首次公开发行股票募投项目“功率半导体研发工程中心升级项目”拟在原有实施地点的基础上新增位于杨舍镇新泾东路616号的租赁厂房作为的实施地点，基于以上募投项目实施地点及实施方式的调整，公司将对该募投项目的内部投资结构同步进行调整，调整前后募集资金总投资金额不变。

1、实施地点和实施方式变更

项目	内容	变更前	变更后
功率半导体研发工程中心升级项目	实施地点	杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢	杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢、杨舍镇新泾东路616号
	实施方式	购置办公楼	购置办公楼及租赁厂房

2、调整内部投资结构

鉴于公司募投项目可行性研究报告编制于 2022 年 1 月，期间随着项目实际建设的开展，公司研发试验设备（含软硬件）需求超出了原可行性研究报告测算金额，主要包括 FT 测试设备（测试机，分选机，编带机）、PIM 模块测试及可靠性考核设备、IC 和器件的可靠性测试设备等。因此，公司根据需求轻重缓急，优先将投资项目用于公司软硬件购置，相应调减研发人员薪资及福利费用等项目，如产生资金缺口将以自有资金补足；同时，公司根据办公场地实际购置费用和此次租赁产生费用，调整了“办公场地购置费用以及租赁费用”拟投入金额。公司此次募投项目内部投资结构调整前后对比如下：

序号	项目	调整前募集资金 拟投资金额（万元）	调整后募集资金 拟投资金额（万元）
1	办公场地购置费用以及租赁费用 （含装修）	3,600.09	3,121.57
2	软硬件购置费用	9,881.00	12,863.95
3	软硬件维护费用	-	200.00
4	设备安装调试费	148.22	-
5	研发人员薪资及福利费用	2,937.85	621.64
6	专利维护、检索	30.00	-
7	数据库维护	150.00	-
8	研发系统及维护	60.00	-
	合计	16,807.16	16,807.16

（二）本次募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的必要性

1、缓解场地制约，保障可靠性考核实验能力提升

提升功率半导体可靠性考核实验能力，是保障产品质量、缩短研发周期、支撑规模化量产、满足高可靠领域和工业控制领域严苛认证要求、降低产品全生命周期风险、推进国产替代的核心战略刚需，更是应对当前市场需求爆发、产品升级迭代的迫切需要。而现有场地条件已成为制约实验能力提升的核心因素，具体体现在以下方面：

（1）市场需求快速增长，现有场地支撑的实验能力存在显著缺口：公司 2025

年高可靠领域出货量较 2024 年实现大幅增长。高可靠领域产品需严格执行早期失效剔除（EFR）流程，以大幅提升产品良率与出厂可靠性。据行业数据显示，功率器件 70%以上的现场失效源于晶圆微管、封装空洞、界面污染等早期缺陷，通过大样本、高覆盖率的可靠性筛选，可将产品出厂失效率从数百 PPM 降至数十 PPM，有效降低客户端返修及召回风险，这对实验场地规模及能力提出了更高要求，原有办公楼场地已无法承载新增实验设备及测试任务。

（2）头部客户准入及行业标准升级，需充足场地支撑实验能力：2025 年，公司已成功导入部分工业控制领域头部客户供应链。车规（AQG324、AEC-Q101）、工业（IEC 60749）、光伏（IEC 61683）等行业标准，对产品测试项目、样本量、失效判据均有明确强制要求；同时，头部客户常提出定制化加速应力、极限工况验证等个性化需求，现有场地及配套设施已无法满足上述客户准入及合作要求，成为制约公司拓展高端客户的瓶颈，亟需通过新增实施地点、调整实施方式提升实验能力。

（3）第三代半导体 SiC 产品升级，需新增场地覆盖专项测试需求：公司在第三代半导体 SiC 产品领域的布局逐步深化，该类产品具备更高电场、更高结温、更快开关速度的特性，形成电-热-力-化学多场耦合的复杂失效模式，需新增高频动态应力、高温栅偏、超结耐压、封装寄生敏感等专项测试项目。现有实验场地及配套条件已无法覆盖相关测试需求，必须通过新增实施地点、优化实施方式，扩大实验规模、完善测试配套体系。

2、保障 CNAS 实验室建设，突破高端市场准入壁垒

CNAS 实验室认可依据 ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力认可准则》实施，是国内实验室能力的最高等级认证，其认可结果可通过 ILAC-MRA（国际实验室认可合作组织多边互认协议）实现国际跨境互认。半导体设计公司作为产业链核心环节，其产品可靠性、性能一致性直接决定终端设备的安全与稳定。随着新能源汽车、工业自动化、医疗电子、光伏储能等高端应用领域对芯片要求的持续升级，以及国产替代进程中“自主可控”需求的日益迫切，建设具备 CNAS 认可资质的内部实验室，已成为半导体设计公司突破发展瓶颈、构建核心竞争壁垒的战略选择，更是本次募投项目“功率半导体研发工程中心升级项目”实现升级目标、提升核心竞争力的关键举措。原有实施地点及方式已无法满足 CNAS

实验室建设及认证相关要求，具体论证如下：

(1) 满足 CNAS 实验室建设的基础场地要求，为认证通过提供前提保障。CNAS 实验室对场地面积、布局规划、环境控制（含温湿度、洁净度等）均有明确且严格的标准要求，是实验室通过认证的基础条件。原有办公、实验一体化办公楼，不仅区域面积不足，且场地布局无法满足 CNAS 实验室对测试区域、样品存储区域、数据分析区域的分区规范要求，无法通过 CNAS 认可审核。本次新增租赁厂房作为项目实施场所，并同步调整实施方式，按照 CNAS 实验室建设标准科学规划场地布局、配置配套设施，可彻底解决原有场地瓶颈，为工程中心取得 CNAS 认证奠定坚实的场地基础。

(2) 破解第三方测试痛点，满足高端市场准入需求。当前，车规级（如车企、Tier1 供应商）、工业级（如工控大厂、电网设备商）、医疗电子、海外头部客户等，在供应链准入环节明确要求供应商提供“CNAS/ILAC 互认的测试报告”，这是高端供应链的“硬性通行证”。若无法取得 CNAS 认证、无自建 CNAS 实验室，公司将面临“连送样资格都无法获取”的困境，直接错失高端市场。目前，公司核心测试工作依赖第三方测试机构，存在三大突出问题：一是测试周期长，第三方测试机构订单排队普遍，严重耽误项目流片迭代与量产节点；二是测试成本高，长期依赖外测将大幅增加运营成本；三是测试数据不可控，第三方测试机构不开放原始测试数据与过程记录，一旦出现测试异常或产品失效，无法追溯问题根源，严重影响失效分析与设计优化效率。通过本次新增实施地点、调整实施方式，推进 CNAS 实验室建设并取得认证，可将核心验证能力掌握在企业内部，彻底解决上述痛点，实现测试需求即时响应，保障公司顺利进入高端供应链。

(3) 加速研发迭代，提升设计成功率与项目推进效率。半导体设计的核心是“试流—测试—优化”的高频迭代，尤其是功率半导体，需通过大量测试验证版图设计、材料选型、封装方案的合理性。若继续依赖第三方测试，单次测试从排队到获取结果需数周时间，严重拖慢研发节奏；而自建 CNAS 实验室、取得认证后，可实现“当天测试、当天出数据、当天迭代设计”，将压缩整体研发周期，大幅提升研发效率与设计成功率，助力公司快速抢占技术制高点。

(4) 强化品牌背书，提升核心竞争力。在半导体行业，客户选择供应商的核心逻辑是“能力信任”，不仅要求企业具备优秀的设计能力，更要求其具备严

格的质量验证能力。CNAS 作为国家级认可资质，是企业测试能力的权威证明，可向客户传递“公司不仅能设计出芯片，更能通过标准测试保证芯片可靠性”的核心信号，有效提升企业品牌知名度与行业话语权。在国产替代进入深水区、行业竞争日趋激烈的背景下，取得 CNAS 认证、拥有自建 CNAS 实验室，可帮助公司在与国际巨头的竞争中占据更有利地位，在市场竞争、政策支持、客户信任等方面形成显著优势，实现高质量发展。

3、优化实施模式，提升项目推进效率与质量

原有实施方式仅依赖单一购置办公楼开展项目建设，实施模式较为单一；同时，受现有场地条件限制，无法实现实验区域、研发区域、办公区域的科学分区，导致研发与测试工作衔接不畅，影响项目推进效率。本次调整实施方式后，采用“原有场地+新增租赁场地”的双场地实施模式，科学划分办公、研发、实验功能区域，实现研发与测试工作的高效衔接；同时，结合新增场地特点优化项目实施流程，可并行开展多方案、多批次验证工作，大幅提升项目推进效率与建设质量，确保项目按期落地见效。

综上，本次募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构，是公司结合业务发展实际、市场需求变化及项目推进过程中的突出问题，作出的科学合理调整，具备充分的必要性与合理性。本次相关调整符合公司长远发展战略，契合募投项目建设的核心目标，有助于补齐项目现有短板，加快技术产业化进程，提升公司核心竞争力，保障募投项目顺利实现预期效益。

四、本次部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的影响

实施方式变更后，公司将相应增加租赁费用投入，并进一步调整研发费用，重点用于可靠性考核实验相关设备采购、CNAS 实验室建设、人才梯队搭建，以及新产品、新技术的研发投入力度。此举有助于加快相关技术与产品的产业化进程，提升产品性能稳定性与一致性，缩短研发及产品化周期，从而更好地把握行业技术发展趋势，持续增强公司的核心竞争力，为公司抢占高端功率半导体市场、推进国产替代奠定坚实基础。

本次部分募投项目变更实施地点及实施方式，是公司基于推进募集资金投资项目建设的实际需要做出的审慎调整，有利于保障募投项目有效管理和顺利实施，

不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在新增募投项目风险及不确定性的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、相关风险提示

公司已就本次新增募投项目实施地点、调整实施方式及内部投资结构事项进行了充分评估和审慎测算。虽然功率半导体行业尤其是高可靠、工业控制及第三代半导体领域存在较大的未被满足的市场需求，且公司现有产品及研发能力展现出良好的技术优势和市场潜力，但行业内已有多家企业布局相关领域，存在一定的市场竞争风险。此外，功率半导体产品的研发、实验验证能力建设具有技术难度高、周期长的特点，前期场地建设、设备采购、技术研发的进展及效果，无法完全预测和保证后续项目建设目标的顺利实现，可能出现新增场地装修、配套设施改造进度不及预期，实验设备安装调试受阻，或研发过程中遭遇技术瓶颈等情况，导致项目开发进度不及预期。公司将持续跟踪项目实施进展，加强对项目的管理，积极采取有效措施防范相关风险。

目前，本次募投项目相关升级改造及实验能力提升工作尚未完成，新增场地尚未正式投入使用，相关研发及实验能力的提升仍需一定周期。基于功率半导体行业技术迭代快、研发投入高、市场竞争激烈等因素的考量，公司将逐步推进新增场地运营及CNAS实验室建设相关工作。但部分环节的顺利推进，并不能保证整个项目及后续相关延伸工作均能顺利开展，可能存在实施效果不及预期的风险。公司在项目推进全过程中，会及时分析行业竞争环境及市场变化趋势，评估项目进展情况，优化项目实施方案，通过自主研发与合作协同相结合的方式推进项目建设及产品布局。

由于功率半导体研发工程中心升级需密集的资金投入，且场地建设、设备采购、研发投入及人才储备等环节需持续投入资金，可能需要较长时间才能实现项目完全落地并产生预期收益。如公司未来无法为本次募投项目后续推进提供足够资金以维持项目正常营运，将被迫推迟、削减或取消部分研发及建设项目，可能对公司业务前景、财务状况及经营业绩造成不利影响。

未来，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，加强募集资金的管理和使用，确保募集资金专款专用。公司将密切关注本次募投项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，保障投资者的知情权。

六、本次调整事项涉及的有关部门审批情况

截至本公告披露之日，项目的相关审批及备案手续正在准备中，本募投项目不涉及环评，可能涉及安评、施工审批等行政审批程序，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致项目实施进度不及预期。为此，公司将积极与相应机构及部门进行沟通，消除不确定因素，推进批复及时取得，确保项目顺利实施。

七、审议程序及专项意见

（一）董事会及专门委员会意见

公司于2026年3月6日召开第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的议案》，同意首次公开发行股票募投项目“功率半导体研发工程中心升级项目”新增位于杨舍镇新泾东路616号的租赁厂房作为实施地点，实施方式由购置办公楼调整为购置办公楼及租赁厂房，同时调整该募投项目的内部投资结构。该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

经核查，保荐机构认为：

公司募投项目“功率半导体研发工程中心升级项目”新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构事项已经公司审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的审议程序，本事项尚需提交公司股东会审议。

公司本次募投项目调整实施方式、新增实施地点和调整内部投资结构事项，是公司结合业务发展实际、市场需求变化作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关规定及公司《募集资金管理制度》。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构事项无异议。

特此公告。

苏州锘威特半导体股份有限公司董事会

2026年3月7日